

有研半导体硅材料股份公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

有研半导体硅材料股份公司(以下简称“发行人”或“有研”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册(证监注册[2022]2047号文)注册。发行人的股票简称为“有研硅”,扩位简称为“有研硅”,股票代码为“688322”。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。发行人已与主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为91元/股,发行数量为187,143,158股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行的战略配售数量为56,142,942股,约占本次发行数量的30.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售认购资金已于规定时间内足额缴纳(主承销商指定的银行账户),本次发行最终战略配售数量为40,546,007股,约占本次发行数量的21.67%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额15,596,940股回拨至网下发行。

战略配售结束后,网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为120,397,151股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.13%;网上初始发行数量为26,200,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.87%。

根据有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告公布的回拨机制,由于网上初步发行数量26,200,000股,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量104,660,143股调整为146,660,000股(即146,660,000股)从网下回拨到网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为105,737,151股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.13%;网上最终发行数量为40,922,849股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.87%。本次发行的网上、网下认购缴款已于2022年11月3日(T+2日)结束,具体情况如下:

一、网下认购情况统计

主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的缴款数据,对本次战略配售、网下、网上的新股认购情况进行了统计,具体如下:

截至2022年10月27日(T-3日),全部战略投资者均已足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(中信证券投资咨询有限公司无需缴纳认购资金),认购结果如下:

本次发行最终战略配售情况如下:

Table with 5 columns: 战略配售对象名称, 战略配售对象名称, 战略配售数量(股), 战略配售金额(元), 占发行总量的比例(%)

(二)网上网下认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股): 40,660,867

2. 网上投资者缴款认购的金额(元): 402,949,191.97

3. 网上投资者放弃认购数量(股): 199,133

4. 网上投资者放弃认购金额(元): 1,973,408.03

(三)网下网下认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股): 105,737,151

2. 网下投资者缴款认购的金额(元): 1,047,853,166.41

3. 网下投资者放弃认购数量(股): 0

4. 网下投资者放弃认购金额(元): 0

5. 网下投资者缴纳的认购经纪佣金(元): 5,239,275.04

二、网下配售摇号抽签

发行人和主承销商于2022年11月4日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号赛金山大酒店四楼会议厅主持了有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海东方公证处公证。

摇号结果如下:

凡参与网下发行申购并获配公开发售方式设立的证券投资基金和其他机构投资者资产管理产品,全国社保基金、基本养老保险基金、基本养老保险基金理事会受托的企业年金、职业年金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和其他合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购账户数量与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行网下网下配售摇号中签的共有4,121个账户,10%的最终战略配售(网上网下配售)对应的账户数量为541个,根据摇号结果,所有中签账户的配售数量按摇号中签账户数量占中签账户总数的比例7.365,407%占,占本次网下发行总量的6.79%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.20%。

本次网下网下配售的配售对象具体情况详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、主承销商统计

网上网下投资者放弃认购数量全部由主承销商包销,主承销商包销的股份数量为199,133股,包销金额为1,973,408.03元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分本次发行数量的比例为0.1388%,包销股份数量占本次发行总规模的比率为0.1049%。

2022年11月7日(T+4日),主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销费用和新股配售经纪佣金后一起划转给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定账户。

四、主承销商联系方式

网下投资者对本公告公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司  
联系人: 殷爱华  
联系电话: 010-23264667  
联系邮箱: project\_cyy@itics.com

发行人: 有研半导体硅材料股份公司  
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司  
2022年11月7日

Table with 5 columns: 序号, 网下配售对象名称, 配售对象名称, 证券账户号, 配售数量(股), 配售金额(元)

Table with 5 columns: 序号, 网下配售对象名称, 配售对象名称, 证券账户号, 配售数量(股), 配售金额(元)

Table with 5 columns: 序号, 网下配售对象名称, 配售对象名称, 证券账户号, 配售数量(股), 配售金额(元)

Table with 5 columns: 序号, 网下配售对象名称, 配售对象名称, 证券账户号, 配售数量(股), 配售金额(元)